

# 苏州国芯科技股份有限公司

## 2024年4月27日至4月29日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2024-008

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位名称</b>	博时基金；嘉实基金；长盛基金；华泰柏瑞基金；融通基金；富安达基金；中信建投基金；申万菱信基金；太平基金；圆信永丰基金；博道基金；申万宏源证券；山西证券；财通证券；浙商证券；中信建投证券；国信证券；中泰证券；国海证券；同方证券；东吴证券；金元证券；德邦证券；兴业证券；中银证券；东海证券；东北证券；东方证券；华西证券；长城证券；申港证券；华泰证券；华福证券；中金公司；中天国富自营；中信兴业；生命保险资管；长城财富保险资管；中意资产管理；工银安盛人寿保险；黑石(福建)投资；浙江三耕资产；丰琰投资；凯恩投资；华美国际投资集团；湖南源乘私募；上海茂典资产；上海聆泽私募；青骊投资；凯恩投资；上海肇万资产；深圳固禾私募；上海赋格投资；海南旗泓私募；敦和资产；深圳市凯丰投资；Prudence；北京城天九投资；Hel Ved Capital Management Limited；益和源资产；上海呈瑞投资；上海睿扬投资；万丰友方；深圳前海华杉投资；灏浚投资；石峰资产；红线资本；深圳固禾私募。

时间	2024 年 4 月 27 日 15:30 2024 年 4 月 29 日 10:00 2024 年 4 月 29 日 15:30
地点	公司会议室及线上交流
上市公司 参加人员 姓名	董事长：郑荭先生 董事会秘书：黄涛先生 证券事务代表：龚小刚先生
投资者关 系活动主 要内容介 绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录，更多关于公司的情况敬请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的定期报告和临时报告。投资者本次提问的问题主要如下：</p> <p>1、请介绍一下公司的高性能量子芯片及量子密码卡的商业进展情况？</p> <p>答：随着量子信息领域研究的深入和量子计算机研制进程的推进，传统密码学越来越无法满足后量子时代的安全需要，广泛使用的 RSA、ECC 等公钥密码体制将处于危险状态，因此利用量子安全技术重构现有信息安全的密码体系已成为未来信息安全产品的必然趋势。量子安全技术的实现方式目前主要分为两类：（1）后量子密码（PQC）；（2）量子密码（Quantum Cryptography）。</p> <p>公司已在这两类量子安全技术方面进行研发。在后量子密码（PQC）方向，公司加强 PQC 方面的密码工程化实现技术研发，包括高性价比的后量子密码算法 IP 研发、后量子密码抗侧信道攻击和防护技术研究以及相应 IP 研发。公司预计在 2024 年内完成支持后量子密码算法的高端 SoC 芯片设计验证工作。</p>

在以量子物理原理为依托的量子密码方向，公司与安徽问天量子科技股份有限公司和合肥硅臻芯片技术有限公司分别组建了量子芯片联合实验室，围绕着量子随机数发生器、量子密钥分发等量子技术和传统芯片、智能终端行业的有机结合，开发适于“量产”的量子安全智能终端可用芯片及设备，主要有量子密码卡、量子安全芯片系列、量子U盘和量子TF卡等。具体包括：

(1) 2022年，公司首次入股合肥硅臻，同年与合肥硅臻合作成功研发的量子密码卡产品问世。该产品是基于公司 CCP903T 高性能密码芯片和合肥硅臻 QRNG25SPI 量子随机数发生器模组设计的一款高速量子密码卡。CCP903T 高性能密码芯片是公司自主研发设计并实现全国产化生产的密码安全芯片，内部以 C\*CORE C9000 CPU 为核心，集成各种高速密码算法引擎、安全防护机制、高速通信接口等，通过国家密码管理局二级密码安全芯片的安全认证。QRNG25SPI 量子随机数发生器模组经国家密码管理局商用密码检测中心测试通过，是基于量子集成光芯片研制的量产化量子随机数发生器模组。该量子密码卡遵循国家密码管理局关于 PCI 密码卡的相关技术规范，具备 PCIE、USB OTG 和 UART 等硬件接口。可广泛应用于密码机、签名/验证服务器、安全网关/防火墙等安全设备以及金融、物联网、工业控制、可信计算和国家重大需求等领域，目前已有多个客户在实际使用。

(2) 2023年，合肥硅臻自主研发的新一代量子随机数发生器芯片“QRNG-10”内部测试成功，该芯片刷新国内量子随机数发生器的尺寸纪录，只有4×4毫米，是国内第一枚突破毫米级尺寸的QRNG芯片，国芯科技配合开展了光后处理电路的研发。该芯片目前已经

通过了国家密码管理局商用密码检测中心的密码检测。国芯科技和合肥硅臻于 2024 年一季度签署了战略合作协议，双方将组建智能终端量子安全芯片联合实验室，基于国芯科技系列化智能终端信息安全芯片和硅臻技术 QRNG-10 量子随机数发生器芯片联合发展智能终端量子安全芯片技术和产品，共同打造中国智能终端量子安全芯片新技术、新产品及新方案。

(3) 量子安全 TF 卡以及量子安全 U 盘 key，用来存储量子会话密钥，量子会话密钥为一次性对称加密密钥，高频次的密钥更新，需要预先在安全 TF 卡内存储大量的量子会话密钥。量子安全 TF 卡以及量子安全 U 盘 key 可以提供 4~32G 的存储容量，具有外部认证等鉴权机制保护密钥的安全；可以提供 SD 通信接口形态以及 USB 接口形态的产品，易于插拔使用。

国芯科技上述多款量子安全产品已经被中电信量子、问天量子、国盾量子等量子领域的头部企业实际采用和实现销售。

## **2、汽车电子芯片市场一季度去库存到底了吗？一季度汽车电子芯片业务的进展情况如何？**

答：截至 2024 年一季度末，通过对汽车电子芯片上下游产业链的观察，并结合公司汽车电子芯片业务的发展及订单情况，我们初步判断汽车电子芯片市场去库存接近尾声，公司一季度的汽车电子芯片的销售数量、收入同比和环比均有一定幅度的增长。

一季度公司的汽车电子芯片业务进展包括：

(1) 国芯科技在汽车域控制芯片领域布局了中高端产品 CCFC30XXPT 系列，其中不仅包括 CCFC3007PT，还包括 CCFC3008PT、CCFC3009PT 和 CCFC3012PT。CCFC3008PT 已经完成实车测试并获得

订单超过 50 万颗。

(2) 针对底盘域及线控底盘的 EPS 和 One-box 应用, 英创汇智、同驭、湘滨等厂商正在开发应用过程中。

(3) 目前用于安全气囊的加速度传感器芯片已内测成功, 可与公司已大规模量产装车的安全气囊控制 MCU 以及开始装车的安全气囊点火驱动专用芯片 CCL1600B 芯片组成方案套片, 为客户提供更高 BOM 性价比的安全气囊电子系统解决方案, 在国内率先可同时提供汽车安全气囊主控芯片、点火驱动芯片和加速度传感器芯片等汽车安全气囊核心芯片。

(4) 公司研发的高端车载音频 DSP 芯片-CCD5001 的开发应用和市场推广也在不断取得进展。公司正与行业头部的音频算法厂商紧密合作, 为用户提供完整且多样的音效和降噪应用方案。

**3、公司一季度信创与信息安全自主芯片业务发展较好, 请介绍一下该项业务的商业发展前景?**

答: 2024 年一季度, 公司自主芯片和模组业务中信创和信息安全收入为 3300 余万元, 较上年同期增长 100%以上。信创和信息安全行业一般一季度收入相对较少, 从一季度收入增长情况及公司目前的在手订单情况看, 2024 年全年该项业务预计相对乐观。

公司为国内极少数拥有“云-端”安全芯片及模组产品的厂商, 部分产品比肩国际一线水平, 已经成为国内领先的信创和信息安全芯片及模组研发企业。目前, 公司已形成较为完备的信创与信息安全产品群, 包括:

(1) 由 CCP903T 系列、CCP907T 系列、CCP908T 系列以及量子密码卡等构成的云安全芯片产品群。前述云安全芯片产品已获得

<p>规模化应用；</p> <p>(2) RAID 存储控制芯片长期以来一直由美国的博通、PMC 等公司垄断，经过多年的研发，国芯科技已成功开发基于公司 C*Core CPU 内核 C8000 的第一代 Raid 芯片产品 CCRD3316 及其全国产 RAID 卡 CCUSR8116 产品，实现同类产品的全国产化替代，该产品已经实现小批量出货和收入确认；</p> <p>(3) 由 CUni360S、CCM3310S-H、CCP903T、CCP907T 等构成的 TCM2.0 可信安全芯片及模块系列，已实现规模化应用；</p> <p>(4) 由 CCM3310S-T 前端安全芯片、CCM3302S 安全 TF 卡、CCM3305S 前端/汇聚端安全芯片以及高速 USB3.0 USBKey 产品、CCP907T 云安全芯片以及高性能密码卡产品等构成的视频安防安全芯片和模组产品系列，已实现规模化应用；</p> <p>(5) 公司研发的金融终端安全芯片产品群包括 CUni360S-Z、CCM4202S 以及 CCM4208S 等多款产品，广泛应用于智能 POS、传统 POS、电签 POS、mPOS 等产品中。前述金融终端芯片累计出货超过 1 亿颗，已成为行业主流芯片。华智融作为国芯科技在金融终端安全芯片领域的主要客户，已从国芯科技采购芯片近 5000 万颗。</p> <p>公司的信创和信息安全芯片及模块已经完成了与国内主流桌面/服务器 CPU 平台和国内主要操作系统的适配，并完成了与联想长风、清华同方、光电通、奔图、立思辰、深信服等十余家行业头部客户的产品适配，实现了持续批量发货，应用涵盖 PC、服务器、打印机、网络安全设备等广泛领域。</p> <p>目前，公司的 Raid 控制芯片及板卡已经实现小批量销售。同时，公司的第一代 Raid 芯片和板卡方案正在多家国内重点客户进行应</p>
---

	<p>用测试，产品正处于多种适配和认证阶段，且进展顺利。这些适配和认证工作涵盖了多个方面，包括与不同操作系统、硬件平台和存储设备的兼容性测试，以及性能和安全性的评估。未来，随着国芯科技在多家国内重点客户测试开发工作的完成，有望迎来更大规模的量产销售。</p> <p>2024年，公司将紧紧抓住数字技术高速发展带来的历史机遇，不断推出更多的“云”“边”“端”信创和信息安全芯片及模组产品，主要包括：</p> <p>(1) 2024年，面向人工智能和云计算安全、网络安全、高性能网关防护，公司研发新一代云安全计算芯片 CCP917T，主处理器采用高算力 RISC-V 架构的 CRV7AI，并融合了神经网络计算的 AI 协处理单元，可以适应更多高性能计算、高性能处理和人工智能推理等复杂应用场景。加解密速度达到 80Gbps，签名验签速度达到 100 万次/秒，产品具备了高安全性、高可靠性以及高扩展性，总体性能具有行业领先水平，可以适用于各种对安全、性能和稳定性要求高的场合，具有较大的产品应用覆盖面；</p> <p>(2) 同时将继续研发第二代 Raid 芯片，新一代 Raid 芯片基于高性能 RISC-V 处理器，采用三模 SerDes 技术，未来有望实现对目前服务器市场上国外主流 RAID 芯片的国产化替代。RAID 技术主要用于服务器领域，具体应用领域主要面向海量数据存储、AI 计算加速、企业关键应用、边缘计算、视频流媒体和网络应用等服务器产品，特别是信创领域相关服务器产品。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>

---

日期	2024 年 4 月
----	------------